

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 6 月 18 日 (2009.6.18)

【公表番号】特表 2008-537338 (P2008-537338A)

【公表日】平成 20 年 9 月 11 日 (2008.9.11)

【年通号数】公開・登録公報 2008-036

【出願番号】特願 2008-506568 (P2008-506568)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/14 (2006.01)

H 0 5 K 3/36 (2006.01)

H 0 5 K 1/02 (2006.01)

H 0 1 R 4/04 (2006.01)

H 0 1 R 11/01 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/14 J

H 0 5 K 3/36 A

H 0 5 K 1/02 L

H 0 1 R 4/04

H 0 1 R 11/01 5 0 1 C

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 4 月 2 日 (2009.4.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板の第 1 端から第 2 端まで伸びる少なくとも 1 つの導電性配線を表面に有するフレキシブル基板であって、前記少なくとも 1 つの導電性配線が、前記基板の前記第 1 端に接続される第 1 回路と前記基板の前記第 2 端に接続される第 2 回路との間の電氣的接続を形成するように構成されている、フレキシブル基板と、

導電性粒子を含み、前記基板の前記第 1 端及び第 2 端上にある熱硬化性接着剤とを含んでなる、物品。

【請求項 2】

前記熱硬化性接着剤によって前記フレキシブル基板の前記第 1 端に取り付けた第 1 回路、及び必要に応じて前記熱硬化性接着剤によって前記フレキシブル基板の前記第 2 端に取り付けた第 2 回路を更に含む、請求項 1 に記載の物品。

【請求項 3】

前記熱硬化性接着剤が、室温で結晶相を有する、請求項 1 に記載の物品。

【請求項 4】

少なくとも 1 つの導電性配線を表面に有する第 1 フレキシブル基板を提供すること、前記少なくとも 1 つの配線の一部に、導電性粒子を含む熱硬化性接着剤組成物を配置すること、

少なくとも 1 つの配線を有する第 2 基板を提供すること、

前記第 1 基板及び第 2 基板上の対応する配線を位置合わせすること、及び

前記第 1 基板及び第 2 基板を加熱及び加圧下にて接着して、前記対応する配線を電氣的に接触させ、且つ前記導電性配線の融点よりも低い温度で、前記配線周囲の前記接着剤を

流動及び硬化させること、を含む方法。

【請求項 5】

前記接着剤が、異方性導電フィルムである、請求項 1 に記載の物品又は請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記熱硬化性接着剤組成物が、必要に応じてメラミン / イソシアヌル酸付加化合物を含むタック減少剤を更に含む、請求項 1 に記載の物品又は請求項 4 に記載の方法。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の物品を含む、電子物品。